



Produktinformation Targetbonden

Anwendungen:

Targets zur Herstellung von PVD-Schichten in den Bereichen:

- Architektur-Glas/Folien, Photovoltaic, Mikroelektronik und –komponenten, magnetische und optische Datenspeicher, Dekoration/Optik, Hartstoff-, Verschleisschutzschichten, tribologische Schichtsysteme etc.

Targetmaterialien:

Reinmetalle:	Ti, Cr, W, Mo, Nb, Ta, Sn, Zn, Edelmetalle
Al-Legierungen:	TiAl, TiAl, TiSi, TiSi, TiSi, TiB ₂
Cr-Legierungen:	CrAl, CrAl, CrAl, CrSi
Sonderlegierungen:	ZnSn, ZnAl
Keramiken:	WC, B ₄ C, SiB, MoS ₂ , Nb ₂ O ₅ , Ta ₂ O ₅ , WO ₃ , Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ Kohlenstoff

Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Ausführung:

1. Targets als Plattenmaterial.
2. Kompletttargets incl. Bonden von Targetmaterial auf Cu-Rückplatte
3. Bonden zugestellter Targetmaterialien und Cu-Rückplatten
4. Fertigung und mechanische Nachbearbeitung nach Zeichnung

Bond-Technologie:

Targetbonden mit patentierter Löttechnik S-Bond[®]. Prozess mit schwermetallfreien Loten ohne Verwendung von Flussmitteln. Entspricht den aktuellen RoHS-Richtlinien. Schmelztemperatur der Lote ab 220-250 °C.

Anfragen und Lieferzeit.:

Anfragen bitte richten an u.a. Adresse. Bitte mit Zeichnung, Stückzahl sowie gewünschte Reinheit der Materialien. Lieferzeitangabe mit Angebotsabgabe.